

# Dell EMC PowerEdge R6525

## 기술 사양

## 참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

<b>장 1: 기술 사양</b> .....	<b>4</b>
새시 크기.....	5
시스템 중량.....	6
프로세서 사양.....	6
PSU 사양.....	6
지원되는 운영 체제.....	6
냉각 팬 사양.....	7
시스템 배터리 사양.....	11
확장 카드 라이저 사양.....	11
메모리 사양.....	12
스토리지 컨트롤러 사양.....	12
드라이브 사양.....	13
드라이브.....	13
포트 및 커넥터 사양.....	13
USB 포트 사양.....	13
NIC 포트 사양.....	14
직렬 커넥터 사양.....	14
VGA 포트 사양.....	14
IDSDM.....	14
비디오 사양.....	14
환경 사양.....	15
열 공기 제한.....	16
열 제한 매트릭스.....	17

# 기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

**주제:**

- 새시 크기
- 시스템 중량
- 프로세서 사양
- PSU 사양
- 지원되는 운영 체제
- 냉각 팬 사양
- 시스템 배터리 사양
- 확장 카드 라이저 사양
- 메모리 사양
- 스토리지 컨트롤러 사양
- 드라이브 사양
- 포트 및 커넥터 사양
- 비디오 사양
- 환경 사양

# 새시 크기

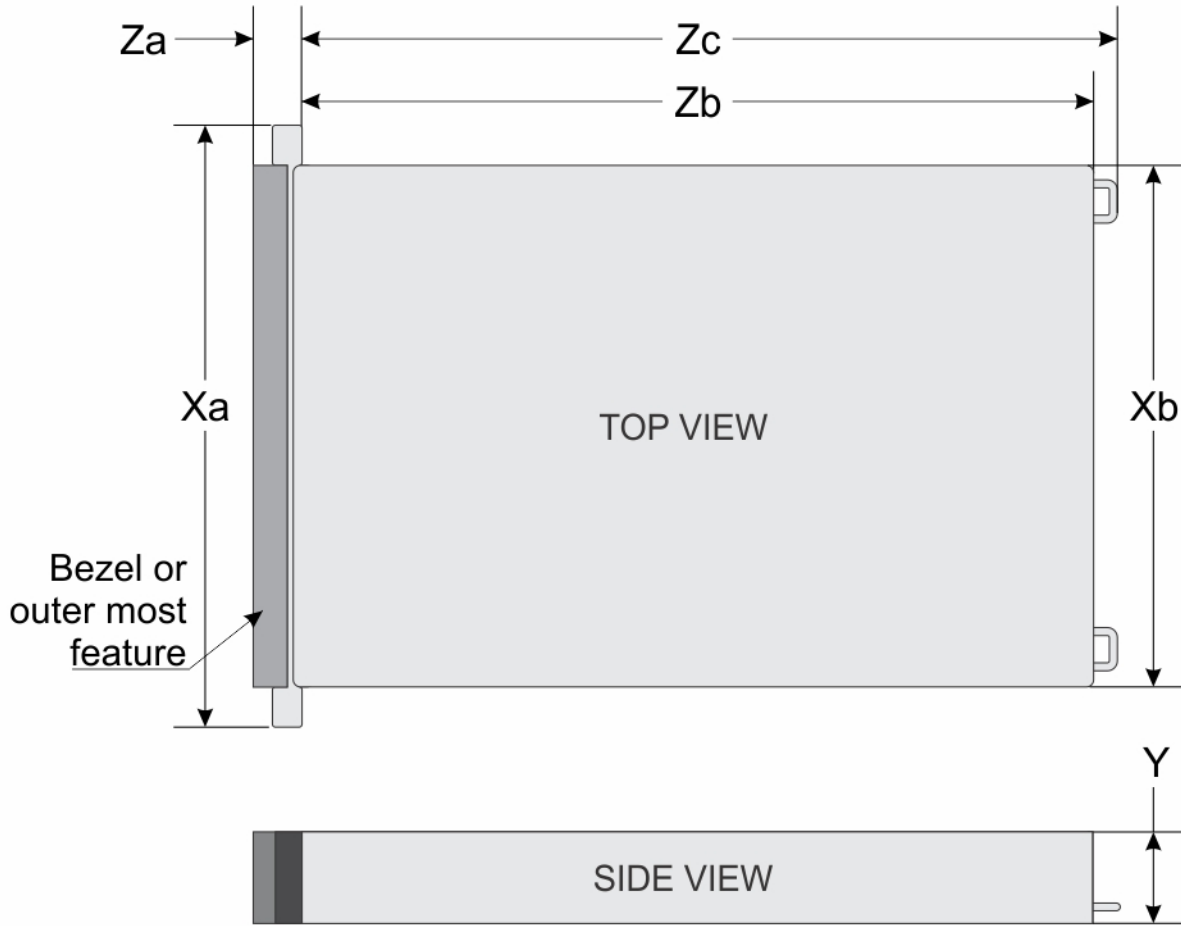


그림 1. 새시 크기

표 1. PowerEdge R6525 새시 크기

드라이브	Xa	Xb	Y	Za	Zb*	Zc
8개의 드라이브	482.0mm (18.97")	434.0mm (17.08")	42.8mm (1.68")	베젤 포함: 35.84mm(1.4") 베젤 미포함: 22.0mm(0.87")	700.53mm (27.58") (후면 벽에 대한 이어)	736.27mm (28.98") (PSU 핸들에 대한 이어)
4개 또는 10개의 드라이브	482.0mm (18.97")	434.0mm (17.08")	42.8mm (1.68")	베젤 포함: 35.84mm(1.4") 베젤 미포함: 22.0mm(0.87")	751.48mm (29.58") (I/O 레이블에 대한 이어)	787.05mm (30.98") (PSU 핸들에 대한 이어)

**노트:** Zb\*는 시스템 보드 I/O 커넥터가 상주하는 공칭 후면 벽 외부 표면을 나타냅니다.

# 시스템 중량

표 2. PowerEdge R6525 시스템 중량

시스템 구성	최대 중량(모든 드라이브/SSD 포함)
4개의 3.5"	21.8kg(48.06lb)
8개의 2.5"	19.2kg(42.33lb)
10개의 2.5"	21.8kg(48.06lb)

# 프로세서 사양

표 3. PowerEdge R6525 프로세서 사양

지원되는 프로세서	지원되는 프로세서의 수
AMD EPYC 7002 또는 7003 Series 프로세서	2개

# PSU 사양

PowerEdge R6525 시스템은 최대 2개의 AC 또는 DC PSU(Power Supply Units)를 지원합니다.

**⚠ 경고:** 공인 기술자 전용 지침:

-(48~60)V DC 또는 240V DC 전원 공급 장치를 사용하는 시스템은 국제 전기 코드 110-5, 110-6, 110-11, 110-14, 및 110-17 조항과 ANSI/NFPA(American National Standards Institute/National Fire Protection Association) 70에 따라 사용 위치가 제한됩니다.

240V DC 전원 공급 장치는 사용 국가에서 해당하는 경우 인증된 전원 분배 장치의 240V DC 콘센트에 연결되어 있어야 합니다.

전원 공급 코드/점퍼 코드 및 연결된 플러그/입력부/커넥터에는 연결에 사용될 때 시스템의 정격 레이블을 참조하는 적절한 전기 정격이 있어야 합니다.

표 4. PowerEdge R6525 PSU 사양

PSU	클래스(AC 전용)	열 손실(최대)	주파수	전압	전류
800W 혼합 모드	플래티넘	3000BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC	9.2~4.7A
	해당 없음		DC	240 V DC	3.8A
1100W 혼합 모드	티타늄	4100 BTU/hr	50/60Hz	100 ~ 240 V AC	12A-6.3A(X2)
	해당 없음		DC	240 V DC	5.2A DC
1100W(-48Vdc)	해당 없음	4265BTU/hr	DC	(-48)-(-60) V DC	27A
1400W 혼합 모드	플래티넘	5250BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC	12~8A AC
	해당 없음		DC	240 V DC	6.6A DC

**ⓘ 노트:** 시스템 구성 선택 또는 업그레이드 시 최적 전원 활용도를 보장하려면 [Dell.com/ESSA](https://www.dell.com/ESSA)에서 Dell Energy Smart Solution Advisor를 사용하여 시스템 소비 전력을 확인하십시오.

# 지원되는 운영 체제

PowerEdge R6525는 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Ubuntu Canonical - Ubuntu Server LTS
- Citrix XenServer

- Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함)
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - VMware vSAN/ESXi
- 자세한 내용은 [www.dell.com/ossupport](http://www.dell.com/ossupport)를 참조하십시오.

## 냉각 팬 사양

PowerEdge R6525 시스템은 최대 4개의 STD(Standard), HPR(High Performance) 실버 등급 또는 골드 등급 듀얼 냉각 팬 모듈을 지원합니다.

표 5. 냉각 팬 사양

팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
표준 팬	STD	STD	레이블 없음	 <p>그림 2. 표준 팬</p>
고성능(실버 등급) 팬	HPR(실버)	HPR	실버	<p><b>①</b> <b>노트:</b> 새 냉각 팬은 고성능 실버 등급 레이블과 함께 제공됩니다. 반면에 기존의 냉각 팬에는 고성능 레이블이 있습니다.</p>

표 5. 냉각 팬 사양 (계속)

팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
				 <p data-bbox="770 1272 962 1305">그림 3. 고성능 팬</p>

표 5. 냉각 팬 사양 (계속)

팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
				 <p data-bbox="772 1272 1086 1303">그림 4. 고성능(실버 등급) 팬</p>
고성능(골드 등급) 팬	HPR(골드)	VHP - 초고성능	골드	<p data-bbox="772 1357 1458 1420">① <b>노트:</b> 새 냉각 팬은 고성능 골드 등급 레이블과 함께 제공됩니다. 반면에 기존의 냉각 팬에는 고성능 레이블이 있습니다.</p>

표 5. 냉각 팬 사양 (계속)

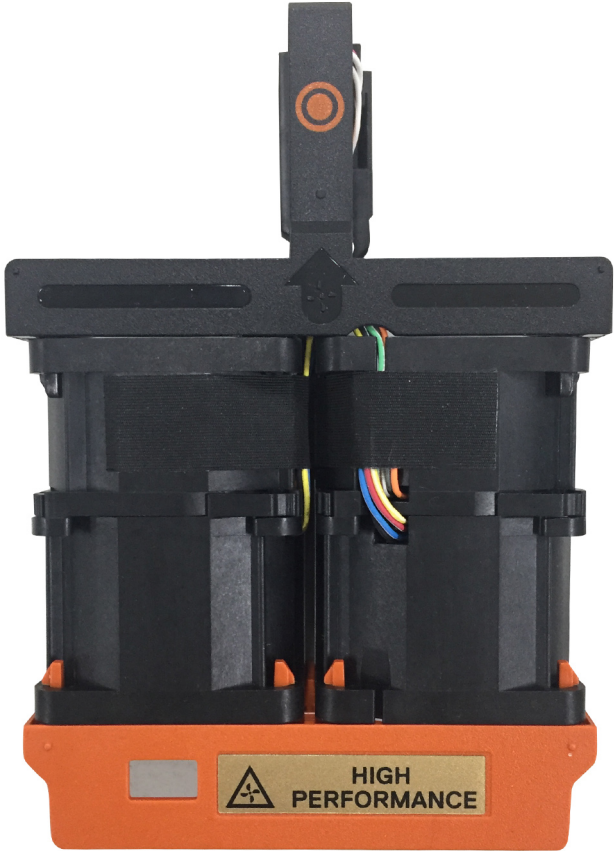
팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
				

그림 5. 고성능 팬

표 5. 냉각 팬 사양 (계속)

팬 유형	약어	별칭	레이블 색상	레이블 이미지
				 <p data-bbox="772 1272 1088 1303">그림 6. 고성능(골드 등급) 팬</p>

- ① **노트:** 레이블의 색상을 기준으로 고성능(실버) 팬과 고성능(골드) 팬을 구별할 수 있습니다.
- ① **노트:** STD, HPR(실버) 또는 HPR(골드) 팬의 혼용은 지원되지 않습니다.
- ① **노트:** STD, HPR(실버) 또는 HPR(골드) 팬 설치의 시스템 구성에 따라 다릅니다. 지원되는 팬 구성 또는 매트릭스에 관한 자세한 정보는 열 제한 매트릭스를 참조하십시오.

## 시스템 배터리 사양

PowerEdge R6525 시스템은 CR 2032 3.0-V 리튬 코인 셀 시스템 배터리를 지원합니다.

## 확장 카드 라이저 사양

**경고:** 소비자 등급 GPU는 Enterprise Server 제품에 설치하거나 사용하지 않아야 합니다.

PowerEdge R6525 시스템은 최대 4개의 PCIe(PCI express) Gen 4 확장 카드를 지원합니다.

표 6. 시스템 보드에서 지원되는 확장 카드 슬롯

PCIe 슬롯	라이저	라이저 너비	PCIe 슬롯 높이	PCIe 슬롯 길이	슬롯 폭
슬롯 1	R2a(라이저 2)	x32 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16
슬롯 1	R1a(라이저 1)	x16 PCIe	FH(Full Height)	3/4 길이	x16
슬롯 2	R2a(라이저 2)	x32 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16
슬롯 2	R4c + R4d(라이저 4)	x16 PCIe	FH(Full Height)	3/4 길이	x16
슬롯 3	R3a(라이저 3)	x16 PCIe	로우 프로파일	HL(Half Length)	x16

## 메모리 사양

PowerEdge R6525 시스템은 최적화된 운영을 위해 다음과 같은 메모리 사양을 지원합니다.

표 7. 메모리 사양

DIMM 유형	DIMM 랭크	DIMM 용량	단일 프로세서		이중 프로세서	
			최소 RAM	최대 RAM	최소 RAM	최대 RAM
RDIMM	싱글 랭크	8GB	8GB	128GB	16GB	256GB
	듀얼 랭크	16GB	16GB	256GB	32GB	512GB
		32GB	32GB	512GB	64GB	1TB
		64GB	64GB	1TB	128GB	2TB
LRDIMM	쿼드 랭크	128GB	128GB	2TB	256GB	4TB
	Octa 등급	128GB	128GB	2TB	256GB	4TB

① **노트:** x4 데이터 너비 및 8Gb DRAM 집적도의 이전 32GB 용량 RDIMM 메모리는 동일한 AMD EPYC™ 프로세서 장치에서 x8 데이터 너비 및 16Gb DRAM 집적도의 최신 32GB 용량 RDIMM 메모리와 혼합할 수 없습니다.

① **노트:** 2666MT/s 속도의 이전 128GB 용량 LRDIMM 메모리는 3200MT/s 속도의 새로운 128GB 용량 LRDIMM 메모리와 혼합할 수 없습니다.

표 8. 메모리 모듈 소켓

메모리 모듈 소켓	속도
32개의 288핀	3200MT/s, 2933MT/s, 2666MT/s

## 스토리지 컨트롤러 사양

PowerEdge R6525 시스템은 다음 컨트롤러 카드를 지원합니다.

표 9. PowerEdge R6525 시스템 컨트롤러 카드

내부 컨트롤러	외부 컨트롤러
<ul style="list-style-type: none"> <li>PERC H755N</li> <li>PERC H745</li> <li>HBA345</li> <li>HBA355</li> <li>S150</li> <li>H345</li> <li>BOSS-S1(Boot Optimized Storage Subsystem); HWRaid 2개의 M.2 SSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12Gbps SAS(외부) HBA</li> <li>PERC H840</li> <li>HBA355E</li> </ul>

표 9. PowerEdge R6525 시스템 컨트롤러 카드

내부 컨트롤러	외부 컨트롤러
<ul style="list-style-type: none"> <li>BOSS-S2(Boot Optimized Storage Subsystem): HWRAID 2개의 M.2 SSD</li> </ul>	

- 이 노트:** PowerEdge R6525 시스템의 전면 PERC 모듈은 드라이브 백플레인에 연결됩니다. 전면 PERC 모듈은 두 가지 방식으로 연결되어 있습니다.
- 전면 마운팅 전면 PERC 모듈
  - 후면 마운팅 전면 PERC 모듈

## 드라이브 사양

### 드라이브

PowerEdge R6525 시스템은 다음을 지원합니다.

- 4개의 3.5" 핫 스왑 가능 SAS, SATA 드라이브
- 8개의 2.5" 핫 스왑 가능 SAS, SATA 드라이브
- 10개의 2.5" 핫 스왑 가능 SAS, SATA 또는 NVMe 드라이브
- 10 + 2개의 2.5" 핫 스왑 가능 SAS, SATA 또는 NVMe 드라이브

백플레인:

- 최대 2개의 2.5" SAS, SATA 또는 NVMe 드라이브
- 최대 4개의 3.5" SAS, SATA 드라이브
- 최대 8개의 2.5" SAS, SATA 드라이브
- 최대 10개의 2.5" SAS, SATA 또는 NVMe 드라이브

- 이 노트:** NVMe PCIe SSD U.2 디바이스 핫 스왑 방법에 대한 자세한 내용은 <https://www.dell.com/support> 모든 제품 탐색 > 데이터 센터 인프라스트럭처 > 스토리지 어댑터 및 컨트롤러 > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > 문서 자료 > 매뉴얼 및 문서에서 *Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 사용자 가이드*를 참조하십시오.

## 포트 및 커넥터 사양

### USB 포트 사양

표 10. PowerEdge R6525 시스템 USB 사양

전면		후면		내장	
USB 포트 유형	서버 내 CPU 수	USB 포트 유형	서버 내 CPU 수	USB 포트 유형	서버 내 CPU 수
USB 2.0 호환 포트	1	USB 3.0 호환 포트	1	내부 USB 3.0 호환 포트	1
마이크로 USB 2.0 호환 포트	1	USB 2.0 호환 포트	1		

- 이 노트:** 마이크로 USB 2.0 호환 포트는 iDRAC Direct 또는 관리 포트에서만 사용할 수 있습니다.
- 이 노트:** USB 2.0 사양은 연결된 USB 디바이스에 전력을 공급하기 위해 단일 회선에 5V 공급을 제공합니다. 유닛 로드는 USB 2.0에서 100mA, USB 3.0에서 150mA로 정의됩니다. 디바이스는 USB 2.0의 포트에서 최대 5개의 유닛 로드(500mA)를 끌어내고 USB 3.0의 포트에서 최대 6개의 유닛 로드(900mA)를 끌어낼 수 있습니다.
- 이 노트:** USB 2.0 인터페이스는 저전력 주변 기기에 전원을 공급할 수 있지만 USB 사양을 준수해야 합니다. 외부 CD/DVD 드라이브와 같은 고성능 주변 기기를 작동시키려면 외부 전원이 필요합니다.

## NIC 포트 사양

PowerEdge R6525 시스템은 LOM(LAN on Motherboard)에 내장되고 OCP 카드(옵션)에 통합된 10/100/1000Mbps NIC(Network Interface Controller) 포트를 최대 2개까지 지원합니다.

표 11. NIC 포트 사양

기능	사양
LOM 카드	2개의 1GB
OCP 카드(OCP 3.0)	4개의 1GbE, 2개의 10GbE, 2개의 25GbE, 4개의 25GbE, 2개의 50GbE, 2개의 100GbE

## 직렬 커넥터 사양

PowerEdge R6525 시스템은 후면 패널에 9핀 커넥터, DTE(Data Terminal Equipment), 16550과 호환되는 1개의 카드 유형 직렬 커넥터(옵션)를 지원합니다.

직렬 커넥터 카드(옵션)는 확장 카드 필러 브래킷과 유사하게 설치되어 있습니다.

## VGA 포트 사양

PowerEdge R6525 시스템은 시스템 전면 및 후면 패널에 위치한 1개의 DB-15 VGA 포트를 지원합니다.

## IDSDM

PowerEdge R6525 시스템은 IDSDM(Internal Dual SD Module)을 선택 사항으로 지원합니다.

IDSDM는 2개의 SD 카드를 지원하며 다음과 같은 구성으로 제공됩니다.

표 12. 지원되는 SD 카드 스토리지 용량

IDSDM 카드
<ul style="list-style-type: none"><li>• 16GB</li><li>• 32GB</li><li>• 64GB</li></ul>

**이 노트:** 1개의 IDSDM 카드 슬롯은 이중화 전용으로 사용됩니다.

**이 노트:** IDSDM 구성 시스템과 연관된 Dell EMC 브랜드 SD 카드를 사용하십시오.

## 비디오 사양

PowerEdge R6525 시스템은 16MB의 비디오 프레임 버퍼를 포함하는 내장형 Matrox G200 그래픽 컨트롤러를 지원합니다.

표 13. 지원되는 전면 비디오 해상도 옵션

해상도	재생률(hz)	색상 수준(비트)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32

**표 13. 지원되는 전면 비디오 해상도 옵션 (계속)**

해상도	재생률(hz)	색상 수준(비트)
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

**표 14. 지원되는 후면 비디오 해상도 옵션**

해상도	재생률(hz)	색상 수준(비트)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

## 환경 사양

**이 노트:** 환경 인증에 대한 추가 정보는 [www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home)에서 매뉴얼 및 문서의 **제품 환경 데이터 시트**를 참조하십시오.

**표 15. 운영 기후 범위 범주 A2**

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비에 직사광선을 받지 않고 10°C~35°C(50°F~95°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~21°C(69.8°F) 최대 이슬점의 80% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/300m(1.8°F/984ft)만큼 감소합니다.

**표 16. 운영 기후 범위 범주 A3**

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 5~40°C(41~104°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~24°C(75.2°F) 최대 이슬점의 85% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/175m(1.8°F/574ft)만큼 감소합니다.

**표 17. 운영 기후 범위 범주 A4**

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	

**표 17. 운영 기후 범위 범주 A4 (계속)**

온도	사양
고도 900m 이하(2,953ft 이하)의 온도 범위	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 5~45°C(41~113°F)
습도 백분율 범위(항상 비응축)	-12°C 최소 이슬점의 8% RH~24°C(75.2°F) 최대 이슬점의 90% RH
운영 고도 디레이팅	최대 온도는 900m(2,953ft) 초과 시 1°C/125 m(1.8°F/410ft)만큼 감소합니다.

**표 18. 모든 범주 간 공유된 요구 사항**

온도	사양
허용할 수 있는 연속 운영	
최대 온도 변화(운영 및 비운영 모두에 적용)	1시간 내 20°C*(1시간 내 36°F) 및 15분 내 5°C(15분 내 9°F), 테이프 하드웨어의 경우 1시간 내 5°C*(1시간 내 9°F) <b>이 노트:</b> *: 테이프 하드웨어에 대한 ASHRAE 열 지침에 따르면 이는 온도의 순간 변화율이 아닙니다.
비운영 온도 제한	-40~65°C(-40~149°F)
비운영 습도 제한	5%~95% RH, 최대 이슬점 27°C(80.6°F)
최대 비운영 고도	12,000m(39,370ft)
최대 운영 고도	3,048m(10,000ft)

**표 19. 최대 진동 사양**

최대 진동	사양
작동 시	5Hz~500Hz에서 0.21G <sub>rms</sub> (모든 운영 방향)
보관 시	15분간 10Hz ~ 500Hz에서 1.88G <sub>rms</sub> (6개 측면 모두 테스트)

**표 20. 최대 충격 펄스 사양**

최대 충격 펄스	사양
작동 시	최대 11ms 동안 x, y, z축으로 ±6G의 연속 충격 펄스 6회
보관 시	최대 2ms 동안 x, y, z축으로 ±71G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 측면에 1회의 펄스)

## 열 공기 제한

### ASHRAE A3 환경

- 180W 이상의 CPU TDP는 지원되지 않습니다.
- 후면 드라이브가 지원되지 않습니다.
- 128GB 이상 용량의 LRDIMM은 지원되지 않습니다.
- 이중화 모드에는 2개의 PSU가 필요하지만, PSU 장애는 지원되지 않습니다.
- Dell에서 공인하지 않은 주변 장치 카드 및/또는 25W를 넘는 주변 장치 카드는 지원되지 않습니다.
- GPU가 지원되지 않습니다.
- BOSS 1.5는 지원되지 않습니다.
- NVMe는 지원되지 않습니다.

### ASHRAE A4 환경

- 155 W 이상의 CPU TDP는 지원되지 않습니다.
- 후면 드라이브가 지원되지 않습니다.
- 128GB 이상 용량의 LRDIMM은 지원되지 않습니다.

- 이중화 모드에는 2개의 PSU가 필요하지만, PSU 장애는 지원되지 않습니다.
- Dell에서 승인하지 않은 주변 기기 카드 및/또는 계층 5 초과 주변 기기 카드는 지원되지 않습니다.
- GPU가 지원되지 않습니다.
- BOSS 1.5는 지원되지 않습니다.
- 계층 4 초과 OCP 3.0 카드 냉각 계층은 지원되지 않습니다.
- NVMe는 지원되지 않습니다.

## 수랭식 냉각: ASHRAE A3 환경

- 128GB 이상 용량의 LRDIMM은 지원되지 않습니다.
- 이중화 모드에는 2개의 PSU가 필요하지만, PSU 장애는 지원되지 않습니다.
- Dell에서 공인하지 않은 주변 장치 카드 및/또는 25W를 넘는 주변 장치 카드는 지원되지 않습니다.
- GPU가 지원되지 않습니다.
- BOSS 1.5는 지원되지 않습니다.
- NVMe는 지원되지 않습니다.

## 수랭식 냉각: ASHRAE A4 환경

- 후면 드라이브가 지원되지 않습니다.
- 128GB 이상 용량의 LRDIMM은 지원되지 않습니다.
- 이중화 모드에는 2개의 PSU가 필요하지만, PSU 장애는 지원되지 않습니다.
- Dell에서 승인하지 않은 주변 기기 카드 및/또는 계층 5 초과 주변 기기 카드는 지원되지 않습니다.
- 계층 4 초과 OCP 3.0 카드 냉각 계층은 지원되지 않습니다.
- GPU가 지원되지 않습니다.
- BOSS 1.5는 지원되지 않습니다.
- NVMe는 지원되지 않습니다.

## 열 제한 매트릭스

표 21. 열 제한 매트릭스

구성		4개의 3.5"			8개의 2.5"		10개의 2.5"(SAS)			10개의 2.5" NVMe	
후면 구성		3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" NVMe(싱글 프로세서)	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max										
120W	150 W	STD 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	STD 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK
155W	180W	STD 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	STD 팬 STD HSK	HPR 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK	VHP 팬 STD HSK
180W	200W	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK

표 21. 열 제한 매트릭스 (계속)

구성		4개의 3.5"			8개의 2.5"		10개의 2.5"(SAS)			10개의 2.5" NVMe	
후면 구성		3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" NVMe(싱글 프로세서)	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max										
200W	200W	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK
225W	240W	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK
280W - 64C (7H12,7763)		HPR 팬* L-유형 HSK	HPR 팬* L-유형 HSK	HPR 팬* L-유형 HSK	HPR 팬 L-유형 HSK	HPR 팬* L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK
280W - 32C (75F3)		-	-	-	VHP 팬* L-유형 HSK	-	VHP 팬* L-유형 HSK	-	-	VHP 팬* L-유형 HSK	-
280W - 64C/32C/24C 280W(7773X, 7573X, 7473X)		-	-	-	-	-	VHP 팬 L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK	VHP 팬* L-유형 HSK	-	-
280W - 16C 280W (7373X)		-	-	-	-	-	VHP 팬** L-유형 HSK	-	-	-	-
T4 또는 A2 GPU		HPR 팬*	HPR 팬*	HPR 팬*	HPR 팬*	-	VHP 팬*	VHP 팬*	VHP 팬*	VHP 팬*	VHP 팬*

① 노트: \* 지원되는 주변 온도는 30°C입니다.

① 노트: \*\* 지원되는 주변 온도는 25°C입니다.

표 22. 수랭식 냉각 열 제한 사항 매트릭스

구성		4개의 3.5"			8개의 2.5"	10개의 2.5"(SAS)			10개의 2.5" NVMe	
후면 스토리지		3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" SAS	후면 2개의 2.5" NVMe	3개의 LP/2개의 FH	후면 2개의 2.5" NVMe
CPU TDP	CPU cTDP Max									
120W	150 W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
155W	180W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
180W	200W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
200W	200W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
225W	240W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
280W	280W	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬
T4 GPU		HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬	HPR 팬

① **노트:** 단일 프로세서에는 3개의 듀얼 팬 모듈이 필요하며 듀얼 프로세서 시스템에는 4개의 듀얼 팬 모듈이 필요합니다.

① **노트:** T4 GPU 및 280W CPU의 경우 지원되는 최대 주위 온도는 30°C입니다. 다른 구성의 경우 지원되는 최대 주위 온도는 35°C입니다.

표 23. 프로세서 및 방열판 매트릭스

방열판	프로세서 TDP
STD HSK	180W 미만
L-유형 HSK	프로세서 1(180W 이상)
L-유형 HSK	프로세서 2(180W 이상)

표 24. 프로세서 Support Matrix

프로세서	TDP(W)	cTDP Max(W)	코어	HSK(Heat Sink) 유형	팬 유형 (x4/x8)	팬 유형 (x10)	지원 A3	지원 A4
7773X	280	280	64	L-유형 HSK	해당 없음	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7573X	280	280	32	L-유형 HSK	해당 없음	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7H12	280	280	64	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7F72	240	240	24	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7F52	225	240	16	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7662	225	240	64	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7643	240	240	56	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7742	225	240	64	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7713P	225	240	64	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요

표 24. 프로세서 Support Matrix (계속)

프로세서	TDP(W)	cTDP Max(W)	코어	HSK(Heat Sink) 유형	팬 유형 (x4/x8)	팬 유형 (x10)	지원 A3	지원 A4
7642	225	240	48	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7552	200	200	48	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7702	200	200	64	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7663	240	240	56	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7543P	225	240	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7542	225	240	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7532	200	200	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7F32	180	180	8	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7513	200	200	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7502	180	200	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
74F3	240	240	24/48	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7402	180	200	24	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7452	155	180	32	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	아니요
7443P	200	200	24	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7443	200	200	24	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7352	155	180	24	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	아니요
7343	200	200	32	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7313P	155	180	16	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	아니요
7302	155	180	16	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	아니요
72F3	180	200	8	L-유형 HSK	HPR(실버) 팬	HPR(골드) 팬	아니요	아니요
7282	120	150	16	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	예
7272	120	150	12	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	예
7252	120	150	8	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	예

**표 24. 프로세서 Support Matrix (계속)**

프로세서	TDP(W)	cTDP Max(W)	코어	HSK(Heat Sink) 유형	팬 유형 (x4/x8)	팬 유형 (x10)	지원 A3	지원 A4
7262	155	180	8	STD HSK	STD 팬	HPR(골드) 팬	예	아니요

① **노트:** 280W CPU가 설치된 경우 빈 슬롯에 DIMM 보호물이 필요합니다.

① **노트:** 프로세서 7573X 및 7773X는 x10 SAS/SATA 드라이브만 지원합니다.

**표 25. T4 GPU 지원 제한 사항**

후면 구성	10개의 2.5"		8개의 2.5"		4개의 3.5"	
	3개의 LP	2개의 FH	3개의 LP	2개의 FH	3개의 LP	2개의 FH
슬롯 1	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨
슬롯 2	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨	지원됨
슬롯 3	지원됨	해당 없음	지원되지 않음	해당 없음	지원되지 않음	해당 없음

① **노트:** 128GB LRDIMM 3200MT/s 이상 메모리는 280W T4/A2 구성에서 지원되지 않습니다.

**표 26. 레이블 참조**

레이블	설명
STD	표준
HPR	고성능(실버 등급)
VHP	초고성능(골드 등급)
HSK	방열판
LP	로우 프로파일
FH	FH(Full Height)